



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

HTG-800D 常规系列

【双组份导热凝胶】规格书



-产品图-

应用特点：

- 8.0(±0.5)W/m.K 导热系数
- 以不定形状替代传统的组装式片材
- 可通过各种手工或自动化的工艺进行点胶
- 柔软，可消除装配应力，减震阻尼
- 固化后可保持所需厚度

应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 用于LED灯具和发光体、汽车和消费领域
- 点胶或直接涂覆成各种厚度和形状
- 高性能中央处理器及显示卡处理器

应用方式：

双组份导热凝胶可通过各种方式使用，包括：自动点胶、手动涂覆。

包装：

根据不同需求，可以按照400cc双管或20L桶装等容量，按照1：1的方式灌注包装。

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：

阴暗处储存，
储存温度：≤30℃；
储存湿度：≤70%；

保质期：

在储存条件下：一年
不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 HTG-800D系列 双组份导热凝胶，是一种可常温固化的导热膏状物，固化后呈现一种柔韧的橡胶弹性体，适用于有散热需求的电子/电气领域，特别适用于不同元器件共用一个散热器大间隙的场合，可自动点胶，以实现自动化作业。

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	A组分	灰色	--
	B组分	白色	--
	混合后	灰色	--

密度	3.35(±0.3)	g/cc	ASTM D 792
混合比例	1:1	--	质量比

挤出速率 @90PSI	10	g/min	φ2.41mmEFD注射头
-------------	----	-------	---------------

最小填充缝隙	0.3	mm	--
--------	-----	----	----

固化条件	表面固化 @25°C	60	min	--
------	------------	----	-----	----

完全固化 @25°C	24	H	--
------------	----	---	----

加速固化 @100°C	5	min	--
-------------	---	-----	----

硫化后

导热系数	8.0(±0.5)	W/m·K	ASTM D 5470
------	-----------	-------	-------------

热阻	≤0.25 (@20psi&1mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470
----	--------------------	----------------------	-------------

硬度	30(±5)	Shore 00	ASTM D 2240
----	--------	----------	-------------

出油率	≤1	%	---
-----	----	---	-----

击穿电压	≥5	kV/mm	ASTM D 149
------	----	-------	------------

体积电阻率	≥10 ⁸	Ω.cm	ASTM D 257
-------	------------------	------	------------

介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
------	----	-------	------------

介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150
------	------	-------	------------

防火性能	V0	--	UL 94
------	----	----	-------

使用温度	-40~125	°C	IEC 60068-2-14
------	---------	----	----------------

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权